

2023深圳智能卡卡片制造展览会(物联网展)

产品名称	2023深圳智能卡卡片制造展览会(物联网展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2023第二十五届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)

物联网专区

时间：2023年11月15-19日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办单位

商务部

科学技术部

工业和信息化部

国家发展改革委

农业农村部

国家知识产权局

中国科学院

中国工程院

深圳市人民政府

联合承办单位

中国机电产品进出口商会

科技部机关服务中心

工业和信息化部国际经济技术合作中心

全国农业科技成果转化服务中心

中国专利保护协会

中科院广州分院

中科院深圳先进技术研究院

国家信息中心

亚洲数据集团

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展览概述

物联网是通过光学识别、射频识别技术、传感器、全球定位系统等新一代信息技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用，被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网发展现在已提到国家的战略高度，它不但是信息技术发展到一定阶段的升级需要，同时也是实现国家产业结构调整，推动产业转型升级的一次重要契机。物联网相关技术已经广泛应用于交通、物流、工业、农业、医疗、卫生、安防、家居、旅游、军事等众多领域，在未来几年内中国物联网产业将在智能电网、智能家居、数字城市、智能医疗、车用传感器等领域率先普及，预计将实现三万亿的总产值。

为协助物联网企业把握这一历史发展机遇，推动我国物联网技术的创新应用与快速发展，积极促进国内外上下游企业间的技术交流与合作，2023高交会物联网专区展将于2023年11月15-19日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第二十五届中国国际高新技术成果交易会工业和信息化专题馆专区之一，专注于整合物联网产业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为物联网企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案，服务国家战略，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的物联网产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给物联网行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓物联网大市场，让我们携手同行，共创商机！

高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体。经过多年发展，高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口，有“中国科技第1展”之称，是中国乃至全世界颇具影响力的品牌展会。高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用。物联网专区作为高交会的重要组成部分，发挥高交会在国际科技交流合作和科技成果产业化等方面的积极作用，为全球物联网企业提供高品质、国际化、综合性的展览体验平台。将更深度探寻物联网产业高质量发展转型实施路径，更聚焦打造优化产业链供应链布局的交流合

作，更直观展现物联网技术与时尚元素交融带来的感官冲击，更着力构建以科技创新和融合创新为核心驱动的物联网产业生态圈，描绘未来物联网技术及创新应用科技给人们生活带来的无限可能。

高交会优势

厚重的历史沉淀，领导的殷切期望：高交会1999年至今已成功举办了24届，一直被誉为“中国科技第1展”，多位领导人先后莅临高交会参观指导，出席历届高交会的GJ领导人有多位全国人大、政协领导。

助力企业腾飞，跨国名企荟萃：高交会为众多企业带来良好收益。微软、IBM、索尼、高通、三星、惠普、西门子、东芝、甲骨文、LG、日立、松下、中国建筑等60多家跨国公司先后多次参展，腾讯、华为、金蝶、科大讯飞、大族激光、同洲电子等一大批中国民营企业从这里走向世界。

行业大咖云集，引领行业发展：透过大会举办的各种论坛、行业研讨会、互动分享会以及技术与产品发布会等活动，获得行业内新动向和发展趋势，参与技术交流，把握行业趋势。

海内外媒体关注，服务多元：每届展会有近200家海内外媒体的约1500多名记者参与报道。不仅包括中国媒体，也有来自海外的主流平面媒体及众多网络媒体。

展品范围

RFID技术及智能卡：

- 1、RFID标签芯片(低频、ISO15693、ISO14443、ISO18000、EPC等标签协议芯片)；
- 2、RFID标签天线(铝质、银质、铜质材料等)、RFID标签天线生产设备；
- 3、标准卡或RFID标签成品(标签卡或RFID标签形式)；
- 4、特殊标签(异形标签或特殊环境应用(如高温、高压、金属、化工等环境))；
- 5、RFID标签或卡生产设备(制卡机、卡封装设备、RFID标签倒装设备、RFID标签自动检测设备)、导电银浆、电池、导磁材料、微波吸收材料、RFID测量测试仪器；
- 6、RFID读写器芯片、RFID读写模块、RFID读写器、天线(超高频、高频、低频)、RFID手持终端、PDA、车载读写器；
- 7、有源RFID产品与系统(433MHz、900MHz、2.45GHz、5.8GHz等有源标签、读写器、天线、系统)、RFID中间件及RFID应用系统解决方案；

芯片提供商：IC卡芯片的设计、开发与生产；芯片晶圆生产技术及相关原材料；

智能卡卡片制造商：接触式和非接触式IC卡及组合式两用IC卡、CPU卡、记忆型卡、异型卡；IC卡及模块的生产与材料；IC卡的凸字印刷、层压和模压；IC卡的个人化图像身份识别(包括制作、印刷和三维立体图形、编码印刷)；IC模块封装；

制卡材料：PVC卡、塑料卡、PET卡、可重复打印卡以及各种记忆材料、安全油墨、薄膜等；

智能卡读写设备提供商：

- 1、符合PBOC 2.0规范的磁卡和IC卡两用的银行ATM机及圈存机、IC卡收款机；

2、计算机与网络的安全接入控制、检测的IC卡技术及设备；

3、门禁控制及相关IC卡设备；IC卡的检测设备；IC卡个人化设备；安全测试技术及设备；与IC卡有关的外设产品与设备，包括各种读写机具、POS终端设备；

系统集成：IC卡各种应用系统集成、COS的设计与开发、IC卡应用软件、安全技术的设计与开发、各类IC卡应用系统(如百货零售系统、市场销售系统、公众系统等)，特别是一卡通；

条形码：一维条码打印机、二维条码打印机、手持式条码扫描器、平台式条码扫描器、碳带、条码色带、

条码碳带、标签、一维、二维条码标签设计软件等；

生物识别；

指纹识别：指纹锁、指纹考勤机、指纹门禁机、指纹考勤门禁机、指纹U盘、指纹采集仪、指纹鼠标、指纹保管箱、指纹移动硬盘、指纹模块、指纹POS机、指纹识别系统；

人脸识别：人脸识别系统、人脸识别考勤机、人脸识别门禁机、人脸识别模块；

虹膜识别：虹膜识别系统、虹膜识别器；

掌纹识别：掌纹识别系统；

视频采集：摄像头、镜头、云台、视频采集卡；

视频传输：视频传输设备及线缆；

存储矩阵：DVR、数字录像设备；

视频识别：监视器、显示设备、CCTV视频监控设备；

传感器、传感网络节点：包括低功耗、小型化、高性能的各类物理、化学、生物新型传感器及其设计、制造和封装，传感器网节点、二维码标签和识读者、RFID标签和读写器、多媒体信息采集、实时定位和地理识别系统及产品；

核心控制芯片及嵌入式芯片：包括MCU、DSP、ADC、GUI、MEMS器件、协议芯片、微电源管理芯片、接口控制芯片和一体化芯片在内的系列物联网各环节的控制芯片；

通信技术与产品：包括NB-IOT、LoRa、WLAN、UWB、Zigbee、NFC、MESH、wimax、WIFI、高频RFID等短距离数据传输及自组织组网的核心产品与设备，异构网融合、传感网相关接口、接入网关等；

网络架构和数据处理：包括面向服务的体系架构(SOA)、物联网云平台、网络与信息安全、海量数据存储与处理、物联网地址编码等设备和产品；

系统集成和软件：包括中间件、网络集成、多功能集成、软硬件操作界面基础软件、操作系统、应用软件、中间件软件等产品；

智能家居系列产品：综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术相关系列产品等；

云计算：数据中心建设及运营，及服务解决方案、超计算、云计算终端用户产品、服务、及解决方案、云应用产品等；

智能交通：智能停车系统、交通管理与控制系统、信号与控制设备与车辆定位系统、车联网等；

可穿戴技术：智能手机，智能手表，手套式手机，智能手环，智能佩戴投影机，指套探测器，Tacit Project手套，智能眼镜，设计方案，IC芯片，锂电池(纽扣电池)，智能触摸屏，智能产品配件(手机外壳，线路板，镜片，耳机，锂电池(纽扣电池))，应用软件，智能腕带，穿戴式电脑，闪存卡(内存)，玻璃镜片，检测设备仪器，LCD，TFT，AMOLED，触摸屏，分析检测仪器；

智能医疗设备：体征监测设备等远程医疗设备、手术辅助机器人及新型医疗仪器等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CHTF

2023，现正接受申请，请速与我们联系索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

未来十年我们将会看到无芯标签的市场份额迅速增加。全球销售量将从2006年占0.4%的5百万增加到2016年占45%的2670亿。按价值计算的话，无芯标签将从2006年只占0.1%的120万美元增长到13.9亿美元——保守估计占2016年RFID标签收入的13%，因为大部分突破性增长都是依靠价格优势。包括制造业、软件业和服务业在内，2016年将有28亿美元的无芯RFID系统市场。其后，无芯标签将通过具技术含量的芯片，例如具有微处理器的金融卡，迅速主宰整个RFID市场。用于不停车道路收费的5.8 GHz标签或者用于实时定位系统的超宽带标签将继续使用硅芯片。